

SL-SMT 5.08HC/13/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

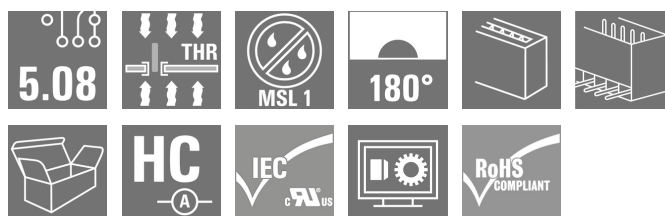
Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THRはんだ接続, 5.08 mm, 極数: 13, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
注文番号	1838320000
種別	SL-SMT 5.08HC/13/180G 3.2SN BK BX
GTIN (EAN)	4032248348381
数量	50 Stück
製品データ	IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A
パッケージ	箱

作成日 2024/07/12 13:22:03 CEST

SL-SMT 5.08HC/13/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	8.5 mm	奥行き (インチ)	0.335 inch
高さ	15.2 mm	高さ (インチ)	0.598 inch
下位バージョンの高さ	12 mm	幅	67.94 mm
幅 (インチ)	2.675 inch	正味重量	5.66 g

システム仕様

製品ファミリー	OMNIMATE信号 - BL/SL 5.08シリーズ	接続方式	基板接続
PCB の取り付け	THT/THRはんだ接続	ピッチ (mm) (P)	5.08 mm
ピッチ (インチ) (P)	0.2 "	外向きエルボ	180°
極数	13	極当たりソルダーピン数	1
ソルダーピン長 (l)	3.2 mm	ソルダーピン長 公差	0 / -0.3 mm
はんだピン寸法	d = 1.2 mm, 八角形	ソルダーアイレット穴直径 (D)	1.5 mm
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)	+0.1 mm	L1 (mm)	60.96 mm
L1 (インチ)	2.4 "	行数	1
ピンモデルシリーズ数量	1	DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	フィンガーセーフプラグ抜き/バックオブハンドセーフのプラグ差込
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護	IP20接続/IP10接続解除	保護度合い	IP20
体積抵抗	≤5 mΩ	コーディング可能	はい
差し込み力 / 極、最大	9 N	引張強度/極、最大	7 N

材料データ

絶縁材	LCP GF	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	IIIa
比較追跡指数 (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
接触表面	錫メッキ	はんだ接続の層構造	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
プラグ接点の層構造	1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C
動作温度、最大	100 °C	温度範囲、設置、最小	-30 °C
温度範囲、設置、最大	100 °C		

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	27.5 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	19 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	24 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	16.5 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	400 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	320 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3	250 V
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2	4 kV	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2	4 kV
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3	4 kV		

SL-SMT 5.08HC/13/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

CSAに準拠した公称データ

試験制度 (CSA)



証明書番号 (CSA)

200039-1176845

定格電圧 (グループ B/CSA 使用) 300 V

定格電圧 (グループ D/CSA 使用) 300 V

定格電流 (グループ D/CSA 使用)

認可値の参照

仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

18.5 A

UL 1059に準拠した公称データ

試験制度 (UR)



証明書番号 (UR)

E60693

定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) 300 V

定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) 300 V

定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) 18.5 A

定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) 10 A

承認値への参照

仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

梱包

パッケージ

箱

VPE 長

168 mm

VPE幅

117 mm

VPEの高さ

38 mm

分類

ETIM 6.0

EC002637

ETIM 7.0

EC002637

ETIM 8.0

EC002637

ETIM 9.0

EC002637

ECLASS 9.0

27-44-04-02

ECLASS 9.1

27-44-04-02

ECLASS 10.0

27-44-04-02

ECLASS 11.0

27-46-02-01

ECLASS 12.0

27-46-02-01

ECLASS 13.0

27-46-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC

/

SL-SMT 5.08HC/13/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

重要なメモ

IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	<ul style="list-style-type: none">• 要求に応じて金メッキの接触面• 定格断面積および最小値に関連する定格電流極数。• はんだアイレットの直径 $D = 1.4 + 0.1 \text{ mm}$• はんだアイレット直径 $D = 1.5 + 0.1 \text{ mm}$、9極から• 図面上の $P =$ ピッチ• 公称データは、コンポーネント自体のみを指します。他のコンポーネントとのクリアランスおよび沿面距離は、関連する適用規格に従って設計する必要があります。• OMNIMATE コネクタは IEC 61984 に準拠した切断容量 (COC) のないコネクタです。指定された使用中、活性化中や負荷がかかっているときにコネクタを抜き差しすることはできません• 平均温度 50°C、最大湿度 70%、36ヶ月の長期保存が可能

承認

認可



ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号 (UR)	E60693

ダウンロード

承認/証明書/適合証明書	CB Certificate CB Testreport Declaration of the Manufacturer
エンジニアリングデータ	CAD data – STEP
カタログ	Catalogues in PDF-format
ブローシャー	FL DRIVES EN MB SMT EN FL DRIVES DE MB DEVICE MANUF. EN FL BUILDING SAFETY EN FL APPL LED LIGHTING EN FL INDUSTR.CONTROLS EN FL MACHINE SAFETY EN FL HEATING ELECTRN EN FL APPL INVERTER EN FL BASE STATION EN FL ELEVATOR EN FL POWER SUPPLY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN
ホワイトペーパーの表面取り付け技術	Download Whitepaper

作成日 2024/07/12 13:22:03 CEST

カタログステータス 29.06.2024 / 当社は技術的変更を実施する権利を有しています。

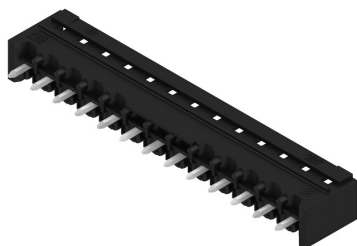
SL-SMT 5.08HC/13/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

製品イメージ



寸法図



製品の利点



安全な電源転送
実績豊富なプロパティ

SL-SMT 5.08HC/13/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

コーディングパーツ



続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。

コーディングエレメントとロックングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます。コーディングエレメントとロックングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。ワイドミューラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。

利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

一般注文データ

種別	BLZ/SL KO OR BX	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1573010000	プリント基板用プラグインコネクタ、アクセサリ、コーディングパーツ、		箱
GTIN (EAN)	4008190048396	橙色, 極数: 1		
数量	100 Stück			
種別	BLZ/SL KO BK BX	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1545710000	プリント基板用プラグインコネクタ、アクセサリ、コーディングパーツ、		箱
GTIN (EAN)	4008190087142	黒色, 極数: 1		
数量	50 Stück			

追加アクセサリ



最適なソリューションを作成する際に、タスクが小さすぎることはありません。

接続はプロセス全体の一部を構成します。多くの場合、小さな詳細情報は、電位がテスト、グループ化、または絶縁されたアプリケーションで最適なソリューションの鍵となります。

システムとは、小さいながらも有用な詳細情報を持たないシステムではありません：

- テストプラグ - 診断ソケットからの信頼性の高いピックアップを確認
- 渡り配線コネクタ - 接続箇所での直接安定した電位分配器を確保
- 区画分割エレメント - 多数のオス型コネクタを、複数の個別ソケットコネクタチャネルに分割
- ロックおよびクリップ - オプションの、オスコネクタとメスコネクタ対応の耐振動クリップのオン接続または取り付け

製造プロセスおよびアプリケーションとの連携 - 多数のアクセサリ = 少ない作業負荷

一般注文データ

種別	SL AT OR	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1598300000	プリント基板用プラグインコネクタ、アクセサリ、スペーサー、橙色, 極		箱
GTIN (EAN)	4008190189266	数: 1		
数量	100 Stück			

作成日 2024/07/12 13:22:03 CEST

SL-SMT 5.08HC/13/180G 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

種別	SL AT SW	バージョン	製品データ	パッケージ
注文番号	1770240000	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, スペーサー, 黒色, 極		箱
GTIN (EAN)	4032248117710	数: 1		
数量	100 Stück			



1,5	0,0	7	35,48	1,200
	-0,3	6	25,40	1,000
3,2	0,1	5	20,32	0,800
	-0,3	4	15,24	0,600
4,5	0,1	3	10,16	0,400
	-0,3	2	5,08	0,200
STIFTLAENGE L	TOLERANZ	n	L1 [mm]	L1 [Inch]

:1



24	116,84	4,600
23	111,76	4,400
22	106,68	4,200
21	101,60	4,000
20	96,52	3,800
19	91,44	3,600
18	86,36	3,400
17	81,28	3,200
16	76,20	3,000
15	71,12	2,800
14	66,04	2,600
13	60,96	2,400
12	55,88	2,200
11	50,80	2,000
10	45,72	1,800
9	40,64	1,600
8	35,56	1,400
7	30,48	1,200
6	25,40	1,000
5	20,32	0,800
4	15,24	0,600
3	10,16	0,400
2	5,08	0,200
n	L1 [mm]	L1 [Inch]

Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260 °C. In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.